



2026 年 10 月 9 日

各 位

会 社 名 大阪有機化学工業株式会社
代 表 者 代表取締役社長 安藤 昌幸
(コード番号:4187 東証プライム市場)
問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長
本田 宗一
TEL 06-6264-5071(代表)

固定資産の取得(新規設備建設)に関するお知らせの一部変更について

当社は、2025 年 12 月 22 日に開示いたしました「半導体関連材料の新規設備建設に関するお知らせ」の内容を一部変更することを本日開催の取締役会において決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、変更箇所には下線を付しております。

記

1. 変更の内容

新規設備建設計画の概要

(変更前)

対象商品	半導体関連材料
所在地	山形県飽海郡遊佐町藤崎字茂り松 157-23
着工/完成 予定	<u>2026</u> 年着工 / <u>2028</u> 年完成 予定
設備投資額	約 <u>100</u> 億円

(変更後)

対象商品	半導体関連材料
所在地	山形県飽海郡遊佐町藤崎字茂り松 157-23
着工/完成 予定	<u>2027</u> 年着工 / <u>2029</u> 年完成 予定
設備投資額	約 <u>200</u> 億円

2. 変更の理由

建設資材価格および設備機器価格の上昇に加え、直近の需要シミュレーションに基づき生産能力の拡充と高純度化技術の向上を目的として導入設備の内容を見直した結果、投資予定額が当初計画を上回る見込みとなったためであります。

また、今回の導入設備内容の変更に伴って工事スケジュールを見直した結果、着工/完成予定も変更されております。

3. 背景と投資の目的

AI や高性能デバイスの進展により、半導体市場は今後も成長が見込まれており、微細化・高集積化に対応する材料の開発と、安定した供給体制の構築は一層重要性を増しています。

当社は、中期経営計画「Progress & Development 2030」(2024 年 11 月期～2030 年 11 月期)に基づき、中量実験室の建設や約 80 億円を投じた生産設備の稼働を通じて、先端半導体用材料の開発・生産体制を強化してきました。

今回の新設備計画では、さらなる生産能力の拡充と高純度化技術の向上を図り、先端半導体用材料の市場シェア拡大と事業発展を目指します。また、金沢工場・酒田工場の 2 拠点生産体制により、BCP(事業継続計画)を確実に実現し、安定した供給体制の構築を推進します。

4. 今後の見通し

本投資による新規設備は 2029 年完成予定の為、当期の連結業績に与える影響は軽微です。今後開示すべき事象が発生した場合は速やかにお知らせいたします。

以上